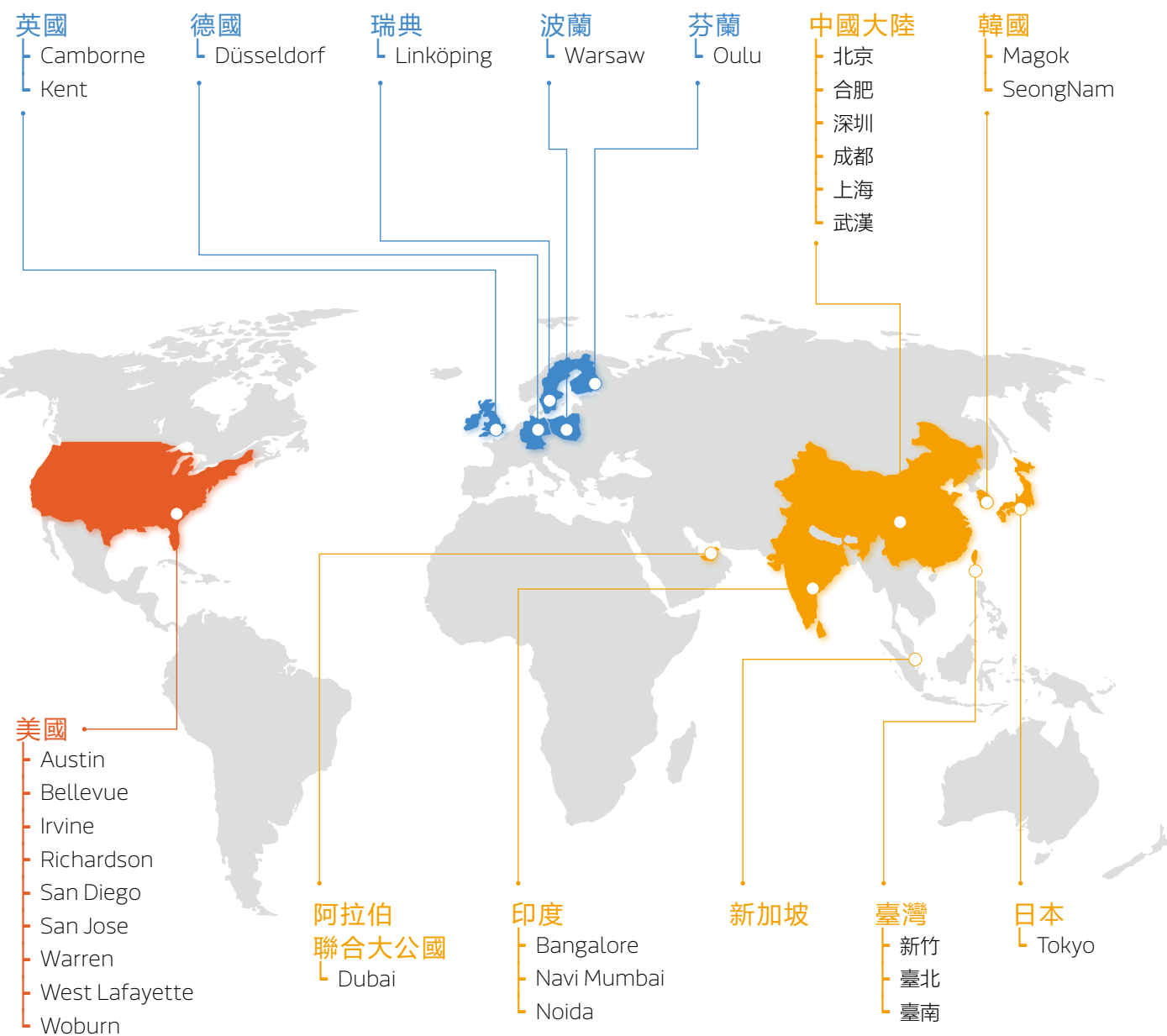


關於聯發科技

聯發科技成立於 1997 年，總部設於臺灣，是一家無晶圓廠的晶片設計公司。產品涵蓋智慧家庭應用、網通寬頻、智慧物聯網、車用晶片、客製化晶片及智慧行動裝置等跨平台晶片設計方案，為全球第五大 IC 設計企業。聯發科技以國際性的視野，運籌全球優秀人才資源，以「全球布局、在地實踐」的方式，為世界各地的客戶提供最即時且優質的產品及服務，以永續發展的態度持續追求所在產業的領導地位。

全球布局

聯發科技以臺灣為營運及研發總部，在歐美、亞洲、中國大陸皆設有辦公據點，運籌全球研發資源與廣納人才，並提供客戶即時支援服務、積極拓展市場。致力於讓科技產品普及世界各角落，透過科技提升及豐富大眾生活。



使命、願景及六大永續焦點

我們以六大面向作為永續發展的基礎，「全球觀、創新、人才、公司治理、綠色營運及在地實踐」，這就是我們創業以來日常營運管理的基石；另外，也期許每位員工秉持公司的六大核心價值，誠信、客戶導向、勇氣深思、創新、兼容並進、不斷精進，為共同使命與願景努力。

使命 | 提升及豐富大眾生活

願景 | 聯發科技致力成為一家全球營運、技術領先的科技公司。藉由不斷提供最具新創性的產品和服務，使客戶獲得成功。

六大永續焦點 | 全球觀、創新、人才、公司治理、綠色營運、在地實踐



企業永續發展委員會組織、策略及涵蓋範圍



2024 年全球榮耀



- ★ 榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」
- 「台灣十大永續典範企業獎」
- 「企業永續報告獎」白金獎
- 「人才發展領袖獎」第一名
- 「創新成長領袖獎」第一名
- 「資訊安全領袖獎」第一名
- 「社會共融領袖獎」第二名
- ★ 榮獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」
- ★ 榮獲《商業周刊》「碳競爭力 100 強」



- ★ 連續五屆榮獲上市公司治理評鑑前 5%
- ★ 榮獲 2024 年 IT Matters Awards 最佳 IT 雇主獎 最佳 IT 專案獎
- ★ 榮獲 SGS IT Awards 車載資安管理卓越獎
- ★ 榮登《Newsweek》「2024 年全球最值得信賴公司」高科技硬體產業榜第二名
- ★ 榮獲 Interbrand「台灣最佳國際品牌」第 3 名，品牌價值 14.04 億美元
- ★ 榮獲全球半導體聯盟 GSA Outstanding Asia-Pacific Semiconductor Company



- ★ 榮獲《天下雜誌》「天下人才永續獎」大型企業組第三名
- ★ 榮登《Forbes》雜誌 2024 World's Best Employers 排行榜
- ★ 榮獲 104 人力銀行首屆「雇主品牌大賞－最佳雇主品牌獎」
- ★ 榮獲《康健雜誌》「CHR 健康企業公民」健康 99 企業



- ★ 榮獲科睿唯安「2024 全球百大創新機構」
- ★ 榮獲律商聯訊「2024 年創新動能：全球百強」
- ★ 榮登「2024 IAM 亞洲智財菁英榜」
- ★ 共計 7 篇論文榮獲國際固態電路研討會 (ISSCC) 論文發表殊榮
- ★ MT6825 5G IoT-NTN 衛星通訊晶片組榮獲「CES 2024 Innovation Award 優選」
- ★ Filologic 860 6 360 Wi-Fi 平台榮獲「2024 EDGE Award 優選」
- ★ Indian Gadget Awards 2024 天璣 7025 榮獲 2024 年最佳行動 SoC (平價) 天璣 8300 Ultra 榮獲 2024 年最佳行動 SoC (主流)

永續價值創造

聯發科技作為全球半導體產業技術領導者，致力研發先進技術和高附加價值產品，不僅提高公司本身之研發密度與員工能力及報酬，研發創新效果帶來的外溢效果，進一步提升整體產業的競爭力 and 就業帶動效應。運用投入產出模型（Input-output Model）分析採購活動衍生的社會與環境外部性，聯發科技 2024 年因採購需求帶動台灣供應鏈創造新台幣 4,859 億元產值，創造 6.34 萬個供應鏈員工就業機會。

全球觀 / AI 無界，智能無限

聯發科技的企業品牌活動「This Chip」致力於讓科技產品更加普及，展現公司對創新和卓越的承諾。在產品端，公司延伸天璣系列 AI 功能，推出全新第二代全大核設計旗艦晶片，並將其 AI 運算能力導入高階 Chromebook、智慧電視及顯示器，讓先進技術觸手可及。此外，聯發科技引領生態系創新，與客戶及合作夥伴共同提高產業附加價值，推動產業持續前進。公司與世界各地知名客戶一起成長，深耕全球潛力市場，涵蓋歐美、中國大陸、亞洲、非洲、澳洲等主要地區。隨著全面 AI 智慧化時代的到來，聯發科技致力於為各種連網裝置帶來先進的 AI 功能，為使用者打造全新、多場景的智慧體驗，透過推動生成式 AI 創新應用的普及，惠及更廣泛的人群，賦能各行各業。每一顆晶片都體現了聯發科技對創新和卓越的承諾，展示其對全球科技進步的深遠影響。

創新 / 智慧終端的領導者 — 行動通訊 / 智慧座艙

聯發科技在 5G 晶片上再度藉由全新的技術突破，推出為邊緣 AI、沉浸式遊戲、極致影像打造最新旗艦 5G Agentic AI 晶片—天璣 9400。藉由在行動通訊上累積的終端 AI 技術能量，聯發科技發表天璣汽車智慧座艙平台新品—CT-X1，CT-X1 採用 3 奈米製程，以先進生成式 AI 技術賦能智慧汽車體驗革新，可為智慧座艙帶來令人驚歎的算力突破，推動汽車產業加速邁入 AI 時代。

人才 / Tomorrow Built by You 攜手打造更美好的明天：聯發科技與全球人才共創未來的旅程

「Tomorrow Built by You 攜手打造更美好的明天」為聯發科技 2024 年正式推出的雇主價值主張（Employer Value Proposition，EVP），透過系統性且運用數據驅動的方法，我們收集超過 3,400 份內外部求職者問卷，同時進行超過 10 場與公司高階主管的對談。藉由分析多元可靠的數據，並經過對焦會議及員工焦點小組，展開專屬於聯發科技的 EVP，並確保其呈現出真實、永續、可信、具吸引力與差異化的理念和價值。

搭配聯發科技 2024 週年公司慶，公司以「Tomorrow Built by You」為主軸推出一系列的溝通及宣傳活動，包含邀請員工分享希望與聯發科技一起打造未來的願景，收到全球超過 500 位同仁的回覆（詳細內容請見：[Tomorrow Built by You — YouTube](#)）。此外，我們也將「Tomorrow Built by You」的視覺設計及訊息理念帶入職場，讓員工親身感受公司期望與員工共創未來的願景，也讓員工成為最好的代言人，讓公司的雇主品牌持續向外延伸。

為了讓外部人才更加了解在聯發科技的職場生活及員工故事，我們推出全新改版的[聯發科技招募網站](#)，展現聯發科技的企業文化、員工故事和職場環境，讓潛在求職者及社會大眾能更全面地了解聯發科技的工作氛圍和職涯機會。

公司治理 / 持續強化公司治理

2024 年公司治理評鑑結果，連續五屆蟬聯上市公司排名前 5% 之優異成績。此外，聯發科技為強化公司治理讓股東充分獲悉公司營運資訊並儘早與股東分享營運成果，於會計年度結束後兩個月內即公布經會計師查核簽證之年度財務報告，並提前於 5 月底召開股東常會；為強化審計委員會對公司財務之監督職能，2024 年各季財務報告均經審計委員會同意，並提交董事會討論決議。

為強化公司治理，聯發科技於 2024 年股東會全面改選董事提高獨立董事佔比至全體董事二分之一。

綠色營運 / 帶動供應鏈減碳共計 40,372ton CO₂e 相當於 104 座大安森林公園年吸附量

以聯發科技綠色製造為目標，聯發科技帶領供應鏈夥伴針對聯發科技產品，從原物料採購到生產製造，以及出貨包裝運輸的過程中所需的設備、零件及廢棄物處理，皆以循環經濟之概念及低碳生產為原則，鼓勵供應商成立持續改善計畫小組，聯發科技偕同供應鏈節能節水專家及循環經濟專家一起進行討論，2024 年共計執行了 28 個減碳相關持續改善專案，減碳效益約 40,372 (ton CO₂e / 年)¹，相當於 104 座大安森林公園年吸附量²。

註 1 電力排碳係數引用經濟部能源署公告 2023 年之電力排碳係數 0.494 (公斤 CO₂e/ 度)

註 2 內政部營建署城鄉發展分署國家重要濕地碳匯功能調查計畫，大安森林公園年碳吸存量為 386 公噸

在地實踐 / 攜手社會創新及 AI 教育領域生態系，放大影響力

社會創新 - 智在家鄉聯合半導體 ESG 夥伴

「智在家鄉」2024 年首次邀請 Arm、日月光、Cadence 等生態系 ESG 夥伴共同參與，打造跨界合作平臺，多元化推進社會創新的資源，並導入聯發科技智能助理平臺，助力參賽團隊提高創新能力，展現了企業協作解決地方問題的新模式。

AI 教育 - 創新教育協同產官學力量

因應全球 AI 教育趨勢，基金會 2024 首辦「教學創新 AI DAY」，匯聚產官學力量，與教育部資科司、均一平臺教育基金會等合作，共同探索 AI 在教育領域的應用前景。活動吸引 512 名教師報名，最後共 100 名入選者深入學習 AI 教學實務，有效回應了教育工作者對 AI 技術的迫切需求。

透過半導體產業 ESG 合作及產官學力量結合的兩種生態系串聯，擴大了社會創新的影響力，同時加速 AI 時代教育創新的推進。